

关键指标

频率：2~6GHz
 功率增益：18dB
 3dB 压缩点输出功率：31.5dBm
 典型附加效率：36%
 电压/静态电流：+8V/345mA, VG:-0.67V
 外形尺寸：2mm×1.7mm

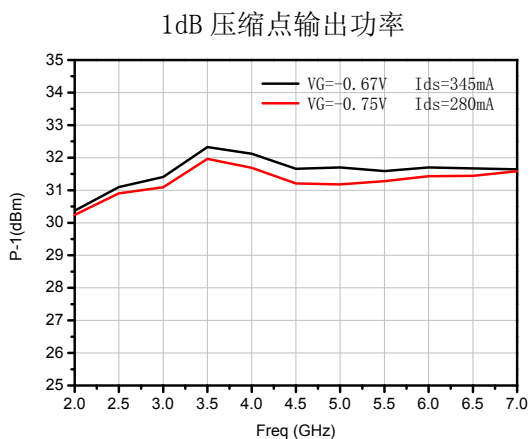
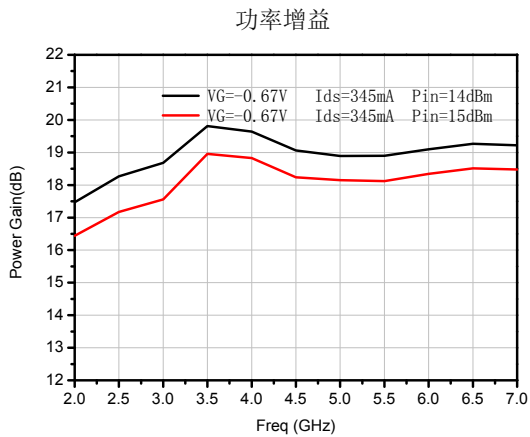
产品简介

HG134F2A 型芯片是一款宽带功率放大器，该芯片为两级放大，工作于+8V，静态电流 345mA，电源端均需要外接滤波电容，射频输入输出端均已集成隔直电容，该芯片主要应用于收发组件、无线通信等领域。

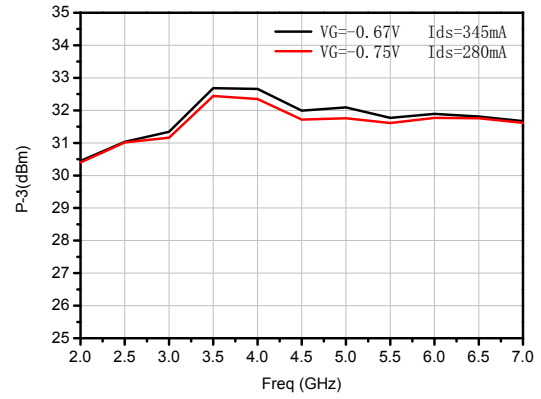
电性能 (T_a=25°C, V_D=+8V, V_G=-0.67V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
功率增益(dB)	-	18	-
3dB 压缩点输出功率(dBm)	-	31.5	-
功率附加效率 (%)	-	36	-
输入驻波	-	1.6	-
静态电流 (mA)	-	345	-

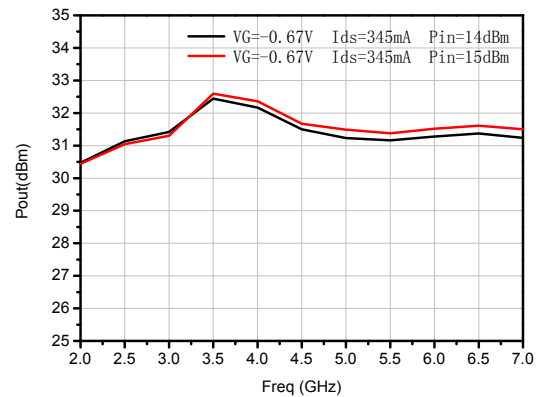
典型测试曲线



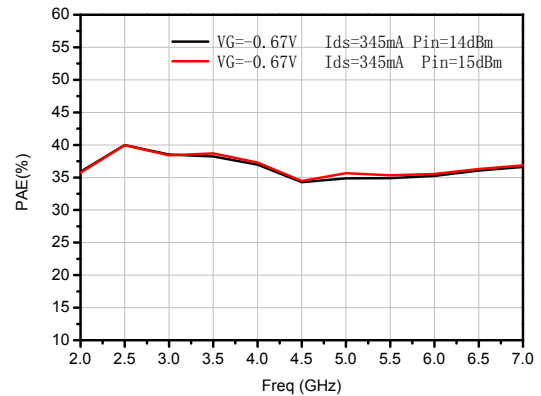
3dB 压缩点输出功率



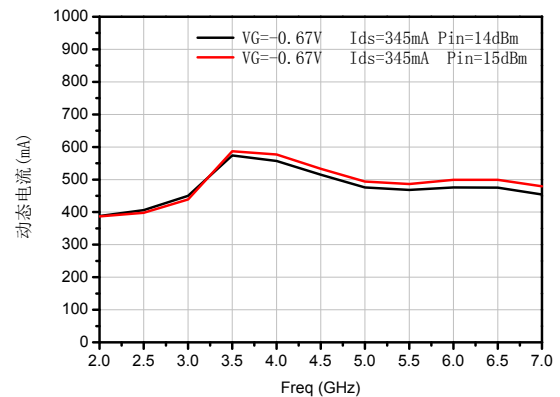
输出功率 vs. Pin



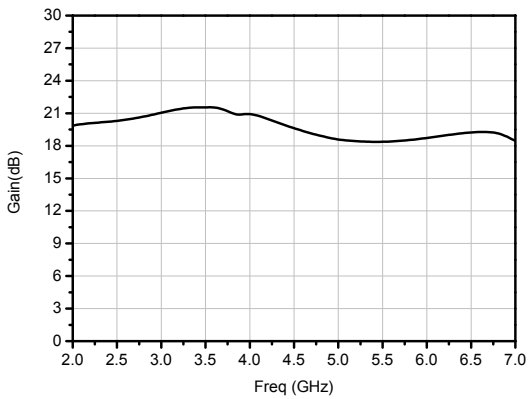
功率附加效率



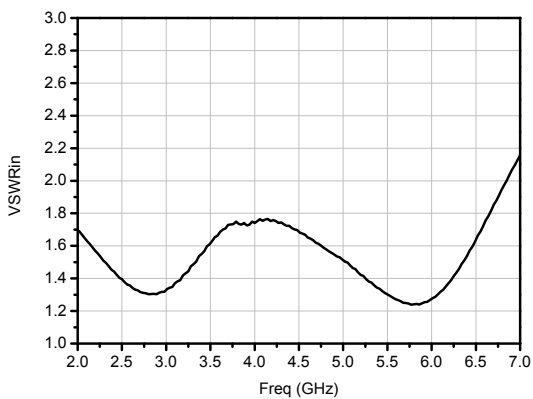
动态电流



小信号增益



输入驻波



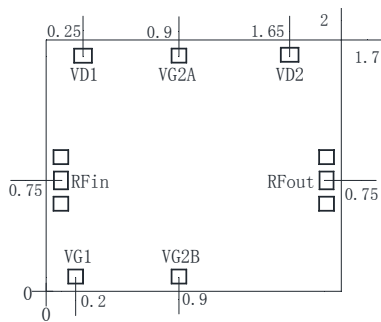
绝对额定最大值

工作电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片采用金锡合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图

